

「半導体アプリケーションチッププロジェクト
(情報家電用半導体アプリケーションチップ技術開発)」評価委員会
(平成 19 年度までに終了した個別テーマの事後評価)

今後の予定

平成 20 年 8 月 22 日 (金) 9:40～18:50
評価委員会 (後日、議事録の確認作業を別途お願いします。)

質問 (メール) に基づき質疑応答

平成 20 年 9 月 1 日 (月)
電子メールにて評点票の提出 (評価委員)
提出先: 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
電子・情報技術開発部 長井 清 まで

平成 20 年 9 月 12 日 (金) 頃まで
テーマ別事後評価報告書 (案) の取り纏め (委員長・事務局) 後、
評価委員に配布し、確認・了承をもらう。

平成 20 年 9 月 19 日 (金) 頃まで
テーマ別事後評価報告書 (案) を、実施者に配布し、
事実誤認の確認、被評価者意見書の作成。

平成 20 年 9 月下旬
テーマ別事後評価報告書の確定

* 質問、評価コメント及び評点票、被評価者意見書の提出先:
(独) 新エネルギー・産業技術総合開発機構 電子・情報技術開発部 長井 清